

2024年3月期 通期決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614

2024年6月

今を見つめなおし
人と社会を一步先へ

1. 事業概要・特長
2. 2024年3月期決算の概要
3. 2025年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

1. 事業概要・特長
2. 2024年3月期決算の概要
3. 2025年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

商号	株式会社シキノハイテック Shikino High-Tech Co., Ltd.
本店所在地	富山県魚津市吉島829番地
代表者	代表取締役社長 宮本 昭仁
設立年月	1975年1月
資本金	421百万円
発行済株式数	4,426,000株
決算期	3月末
事業内容	電子システム事業・・・・・・・・・・半導体検査・装置関連 マイクロエレクトロニクス事業・・LSI設計（アナログ・デジタル）、IP開発 製品開発事業・・・・・・・・・・画像関連機器、CMOSカメラモジュール
従業員数	448名（2024年3月31日時点）
国内拠点	魚津工場、魚津第二工場、 福島事業所 、東京デザインセンター、 横浜デザインセンター 大阪デザインセンター、福岡デザインセンター、九州事業所、熊本事業所

社是

和して拓く

社訓

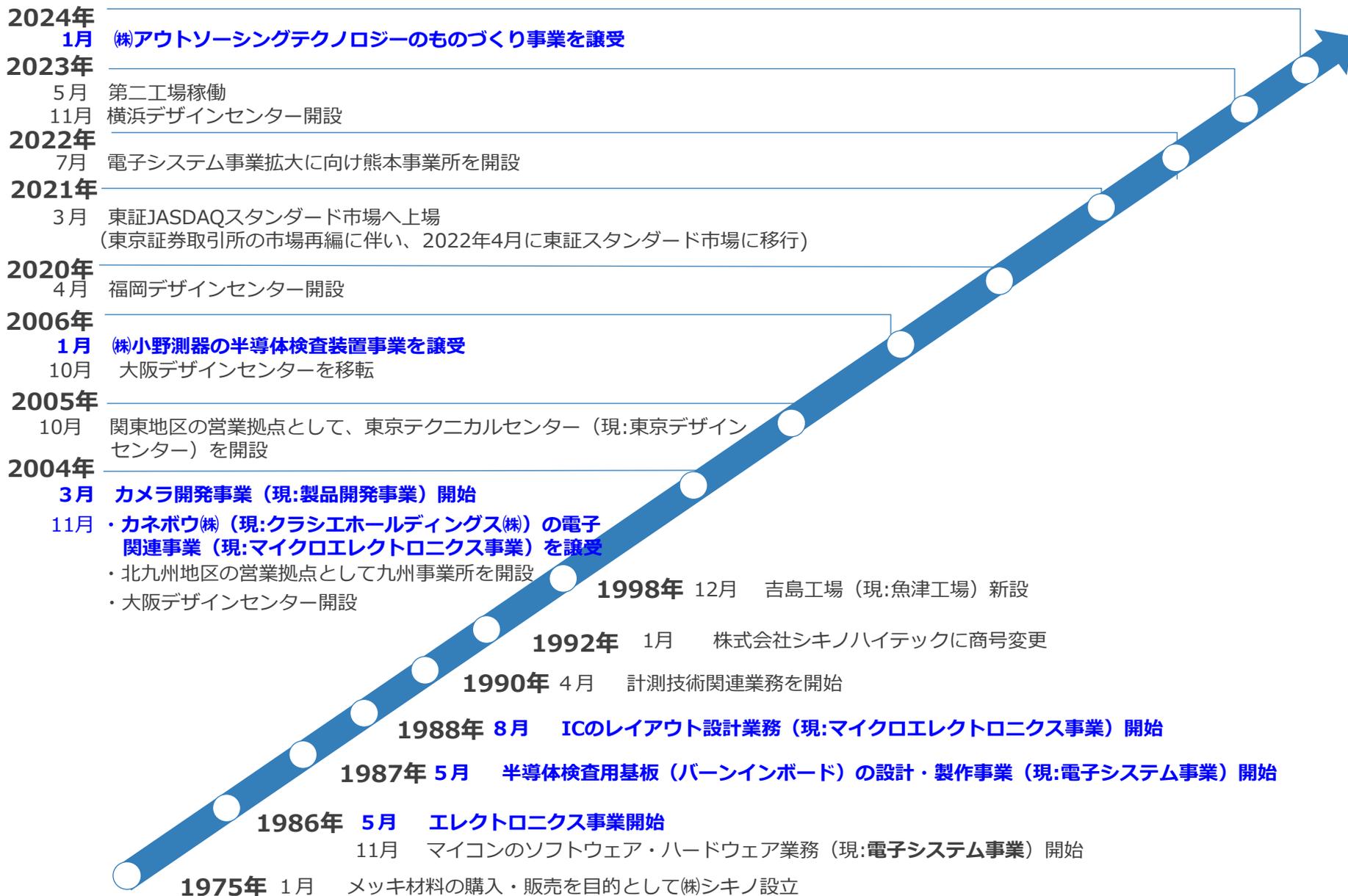
社業を通じ社会に奉仕

企業の永続と繁栄

社員の幸福と人格の向上

経営理念

我が社は、お客様の信頼を得る製品とサービスを創り出し、立ち止まらず、高いモラルを有し、発展し続ける企業を目指します。





電子システム

九州事業所



電子システム

本社、魚津工場



第二工場



電子システム

※24/1～ 福島事業所



マイクロエレクトロニクス

福岡デザインセンター



マイクロエレクトロニクス

製品開発



電子システム

熊本事業所



マイクロエレクトロニクス

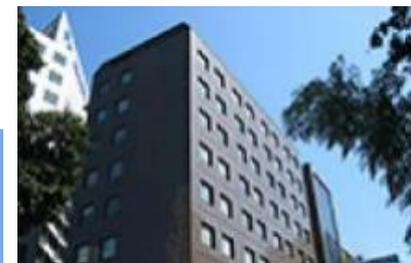
製品開発

大阪デザインセンター



マイクロエレクトロニクス

※23/11～横浜デザインセンター



東京デザインセンター

電子システム事業・マイクロエレクトロニクス事業・製品開発事業の三つの事業を展開。
各事業においてTOPシェアを保有。

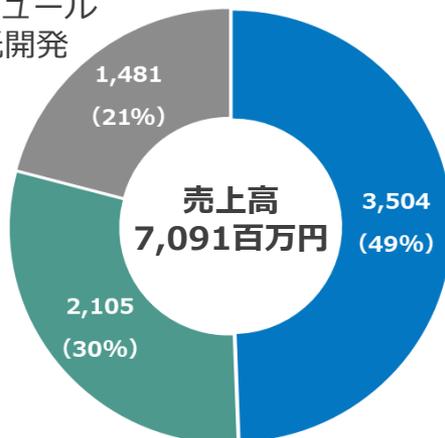
製品開発事業

産業用組込カメラ
国内トップシェア

※当社調べ

組込カメラモジュール・画像システム

CMOSカメラモジュール、画像処理モジュール
画像処理システム・カスタムカメラ受託開発



2023年度
セグメント別売上高比率

電子システム事業

車載向けBI装置
国内トップシェア

※当社調べ

半導体検査・装置関連

バーンイン装置・ボード、カスタムバーンイン装置
各種電子機器検査用ボード、専用計測機、
IoT-Nessum、電子機器の受託開発



バーンイン

半導体の初期不良を除去する選別方法の一種
半導体を通常より高温環境下で動作させる試験

マイクロエレクトロニクス事業

JPEG IP
W/W mobile20%

IPコア (Intellectual Property)
LSIを構成するための部分的な回路情報のうち
特に単一機能をでまとめられたもの

半導体設計 (アナログ・デジタル)、IPコア

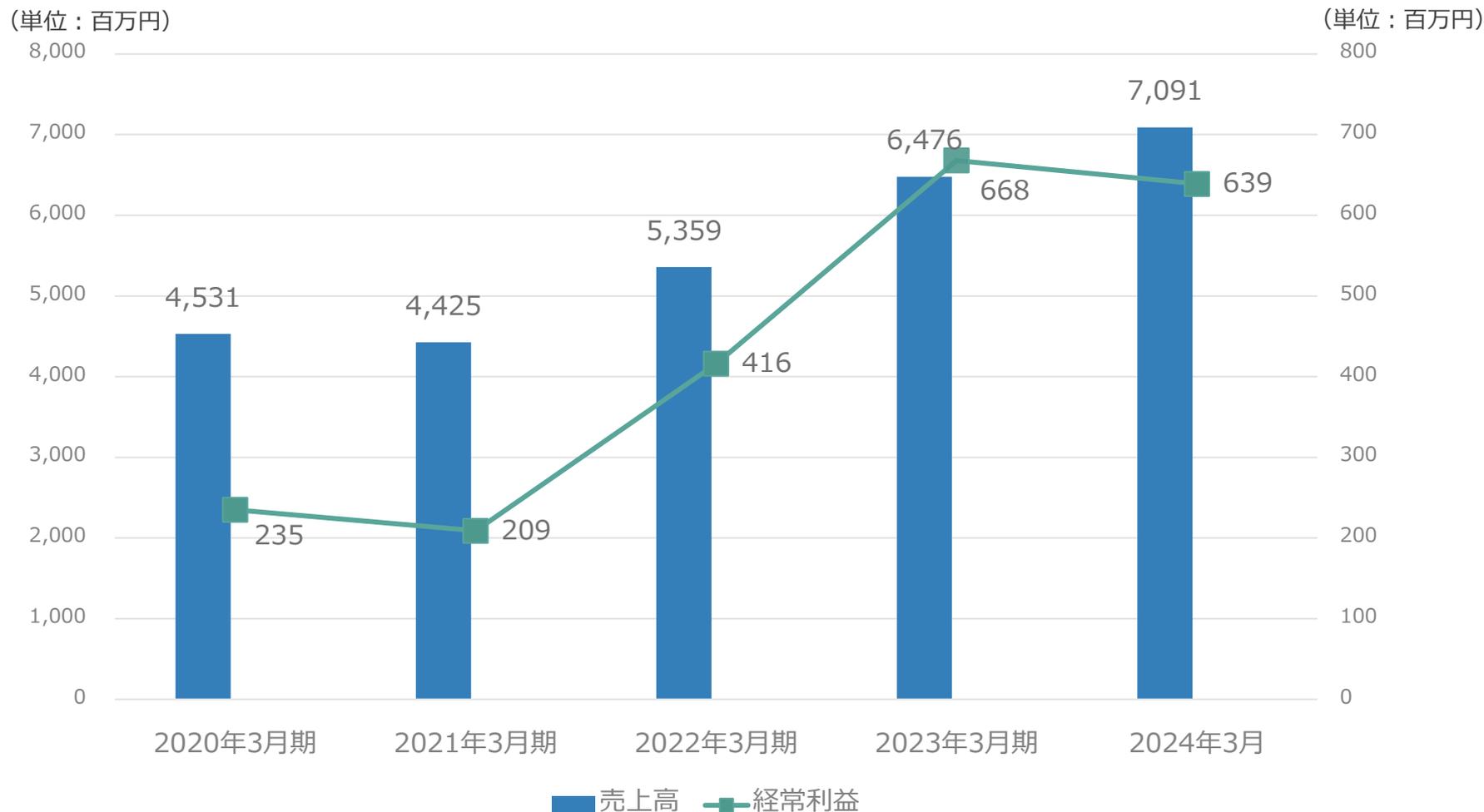
電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、
画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、
IPコア : JPEG、MIPI、ISP



2021年3月株式上場以降 順調に売上増加。売上2021年3月期比 +60%

2024年3月期 経常利益率 9.0% 経常利益率2021年3月期比 +4.3ポイント

売上・経常利益推移の変遷



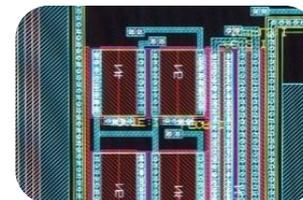
当社の主力分野と強み

高成長が期待できる分野に注力、事業環境上のリスク分散が効く事業ポートフォリオ。
三事業各々で強みを保有、技術・事業連携で事業間シナジーを創出。



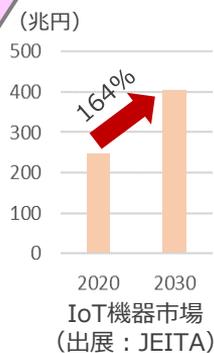
マイクロエレクトロニクス事業

主力分野：成長が期待される半導体
強み：育成に長時間を要する高度アナログ技術を保有
デジタル画像処理技術

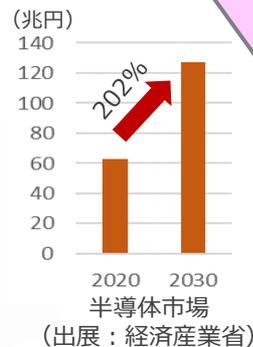
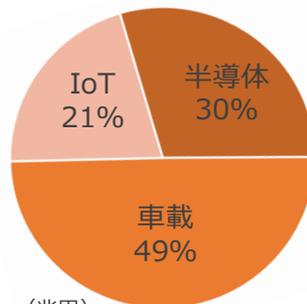


画像信号処理技術

技術活用シナジー



2023年度販売割合



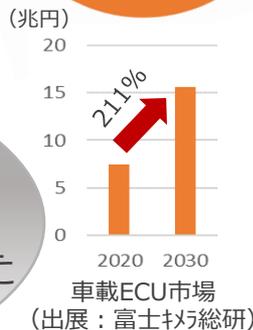
半導体設計・テスト技術

技術活用シナジー



製品開発事業

主力分野：AI技術進化で画像処理分野が拡大するセンシング製品
強み：レンズ～ソフトウェアまで最適化したカメラソリューションを提供



電子システム事業

主力分野：車載電子化に伴う半導体に高い信頼性を保証する試験装置
強み：装置・半導体テストエンジニアを社内に保有

1. 事業概要・特長
2. 2024年3月期決算の概要
3. 2025年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

2023年度（2024年3月期）は増収・増益

- 半導体信頼性試験関連商材、車載機器向け専用計測機および産業機器向けカメラで受注は順調に推移。譲渡事業分含め通期予想以上の増収。
下期以降特定顧客の生産量抑制、設備投資抑制の影響が発生、マイナンバー関連の停滞により伸び率は鈍化。
- 利益面は、工場・拠点の積極投資、労務費上昇、事業譲渡関連費用の発生、原材料やエネルギー価格の高騰等の影響はあったが、最終利益（当期純利益）では前年比で増益。

（単位：百万円）

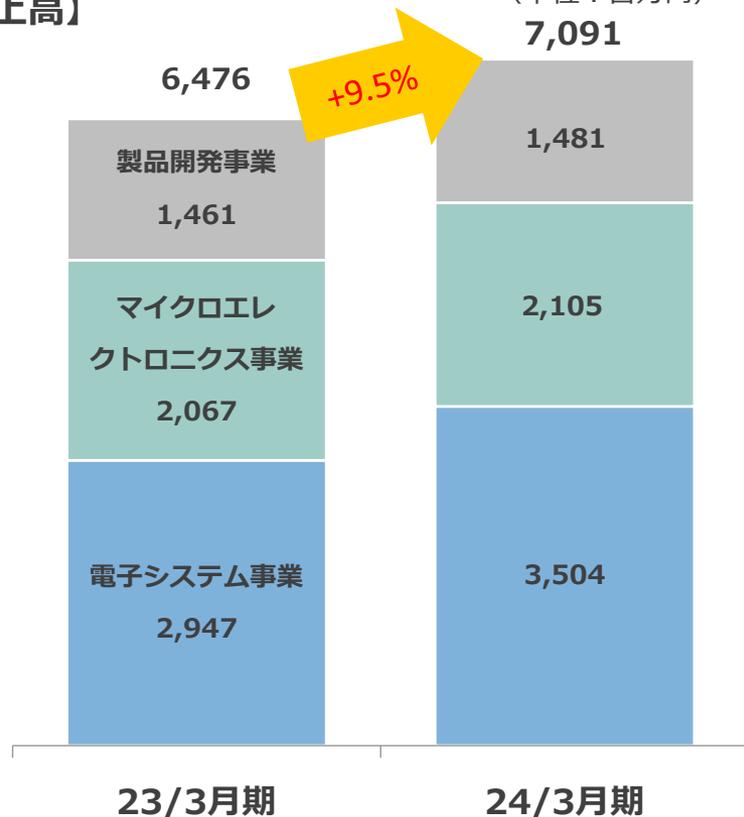
	2024/3月期 通期予想	2024/3月期 通期実績	通期予想 達成率	2023/3月期 通期実績	対前年 増減率
売上高	6,680	7,091	106.2%	6,476	9.5%
営業利益	560	604	107.9%	657	▲8.0%
経常利益	560	639	114.1%	668	▲4.3%
当期純利益	430	509	118.4%	477	6.8%

決算状況① 事業セグメント別実績

- ・電子システム事業はカスタムバーンイン関連商材の受注が増加し前期比+18.9%と大幅増収。下期以降車載用半導体の後工程商材に一服感が現れ伸び率は鈍化したが高規顧客開拓に成果。
- ・マイクロエレクトロニクス事業も旺盛な半導体需要に支えられ堅調に推移。車載分野で受注増。
- ・製品開発事業はマイナンバー読み取りカメラ応用製品の停滞もあったが、アミューズメント機器向けカメラの量産開始など順調に推移し前期比成長は堅持。

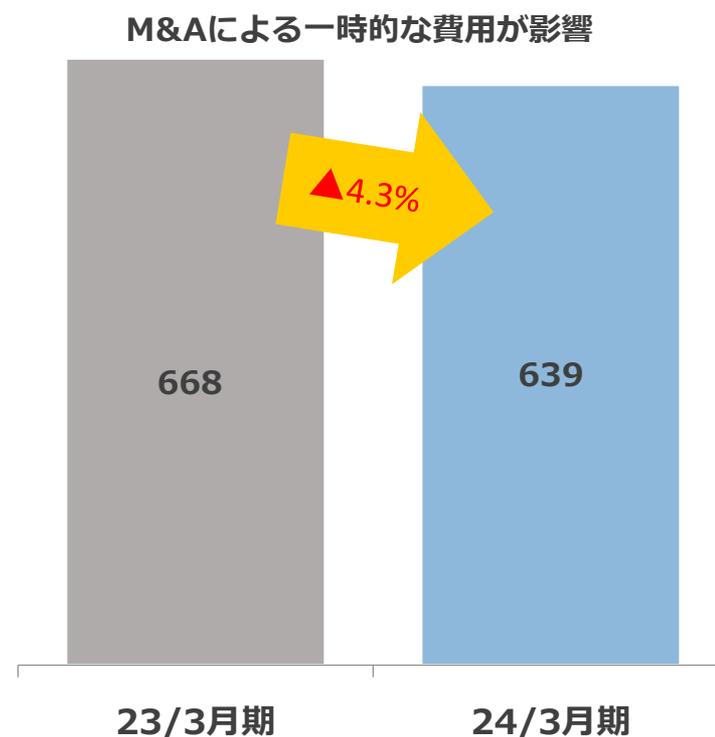
【売上高】

(単位：百万円)



【経常利益】

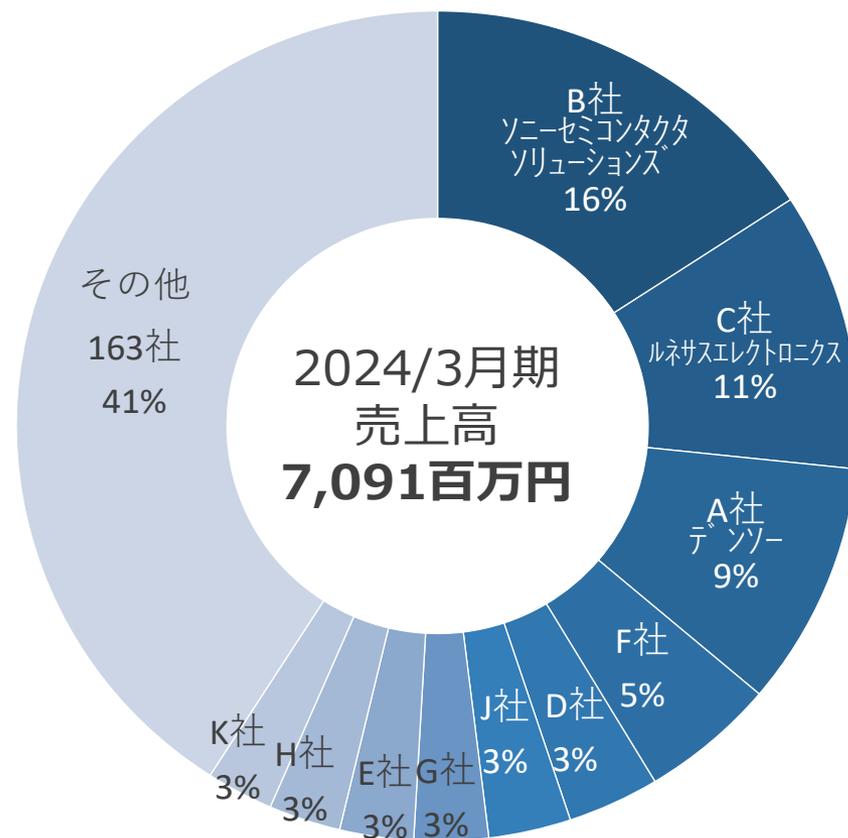
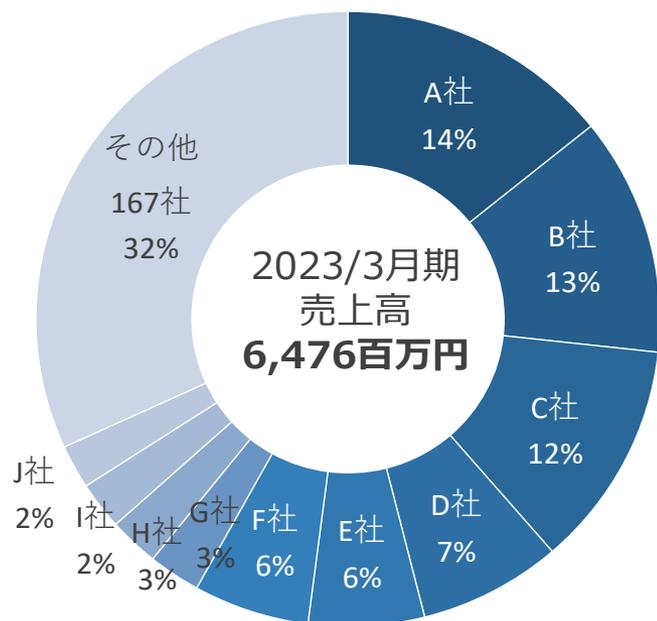
(単位：百万円)



※売上高・経常利益は前期比で増収・減益。

決算状況② 取引先別売上高

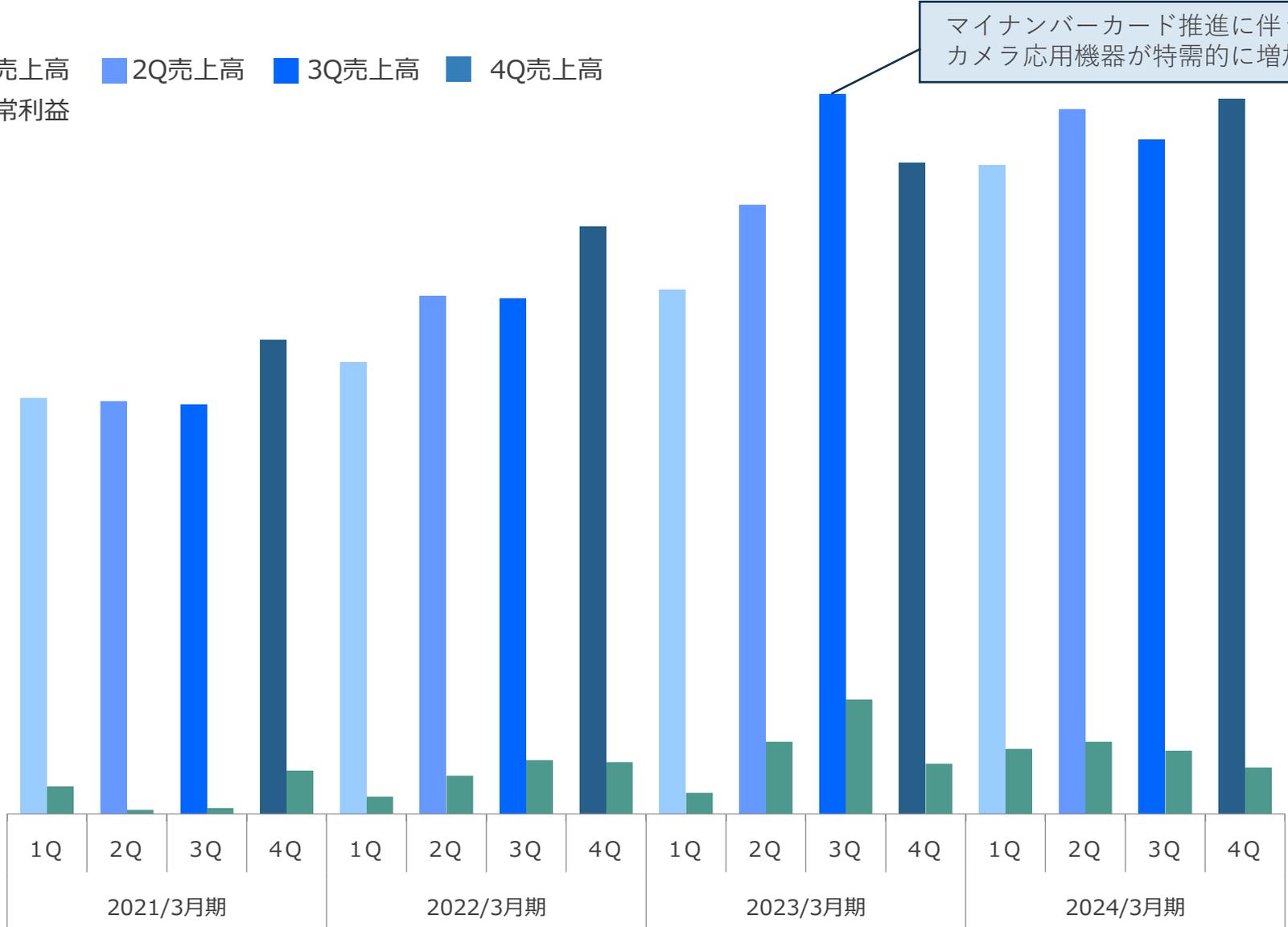
主要顧客との安定的な取引と販売先の分散が図られた強固な顧客基盤。
23年度では主要上位3社は変わらず安定、3社での構成比は36%。



決算状況③ 四半期業績推移

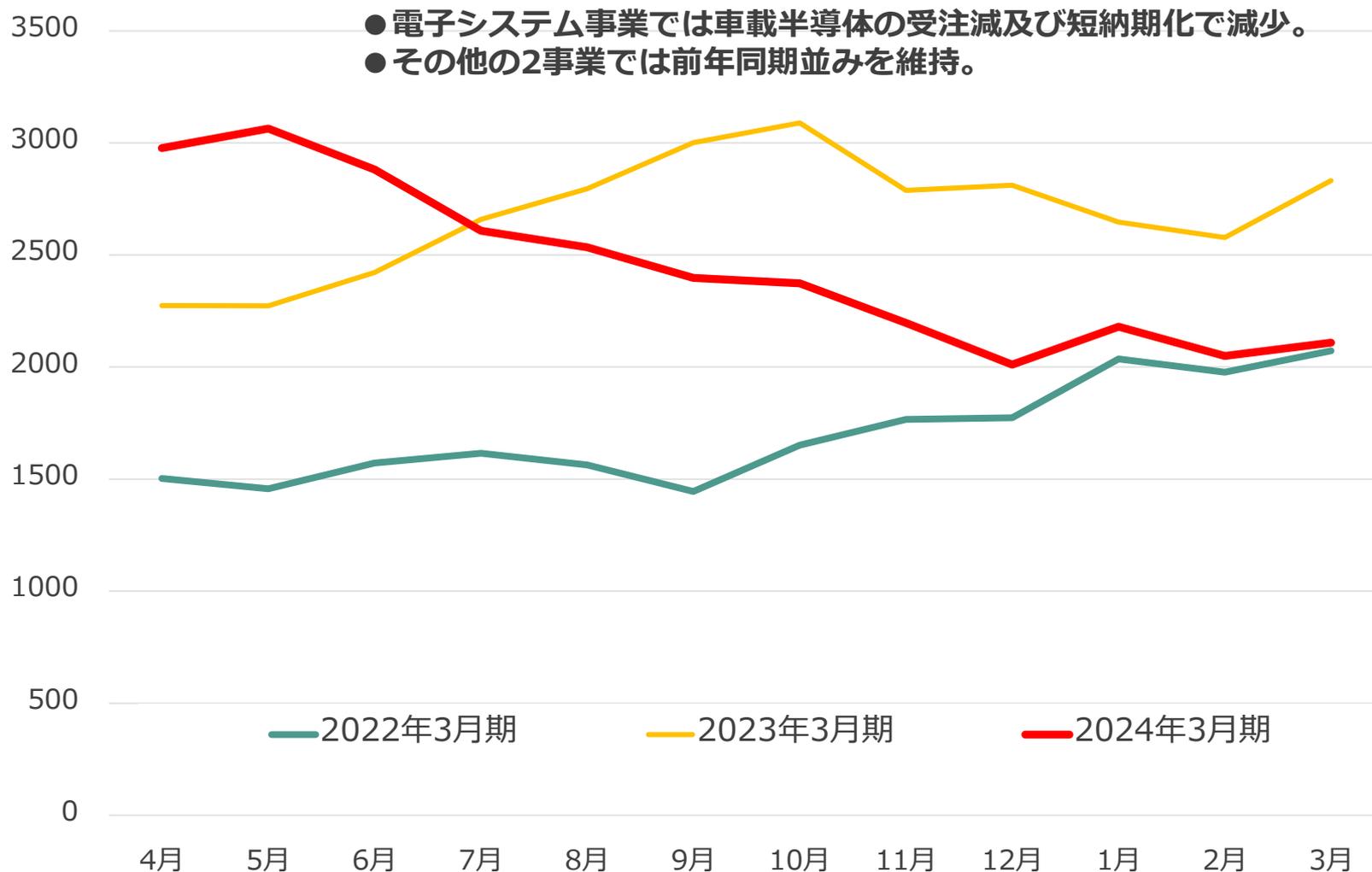
■ 1Q売上高 ■ 2Q売上高 ■ 3Q売上高 ■ 4Q売上高
■ 経常利益

マイナンバーカード推進に伴う
カメラ応用機器が特需的に増加



【受注残高（全社）】

（単位：百万円）

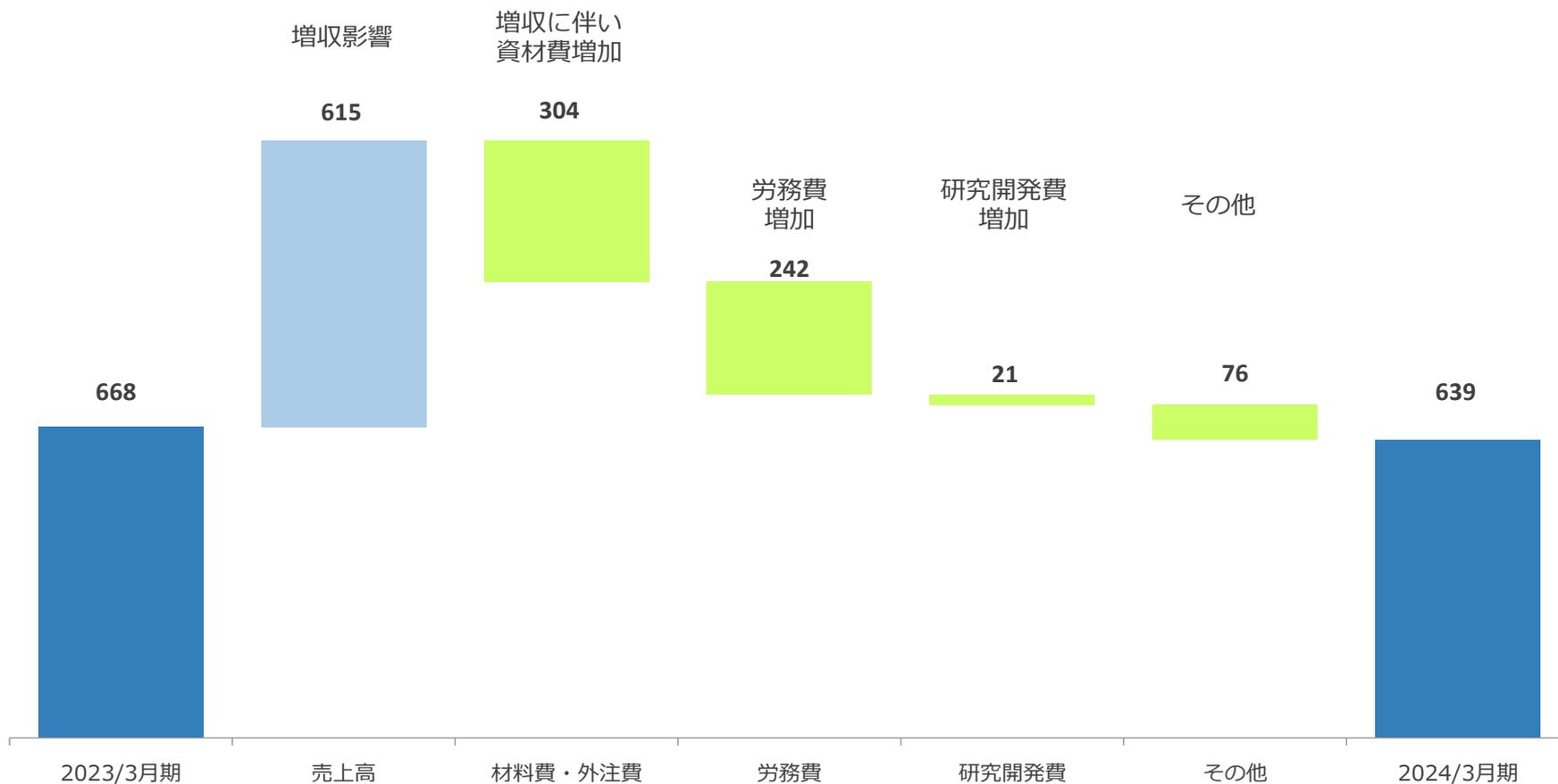


決算状況⑤ 経常利益増減要因

増益要因

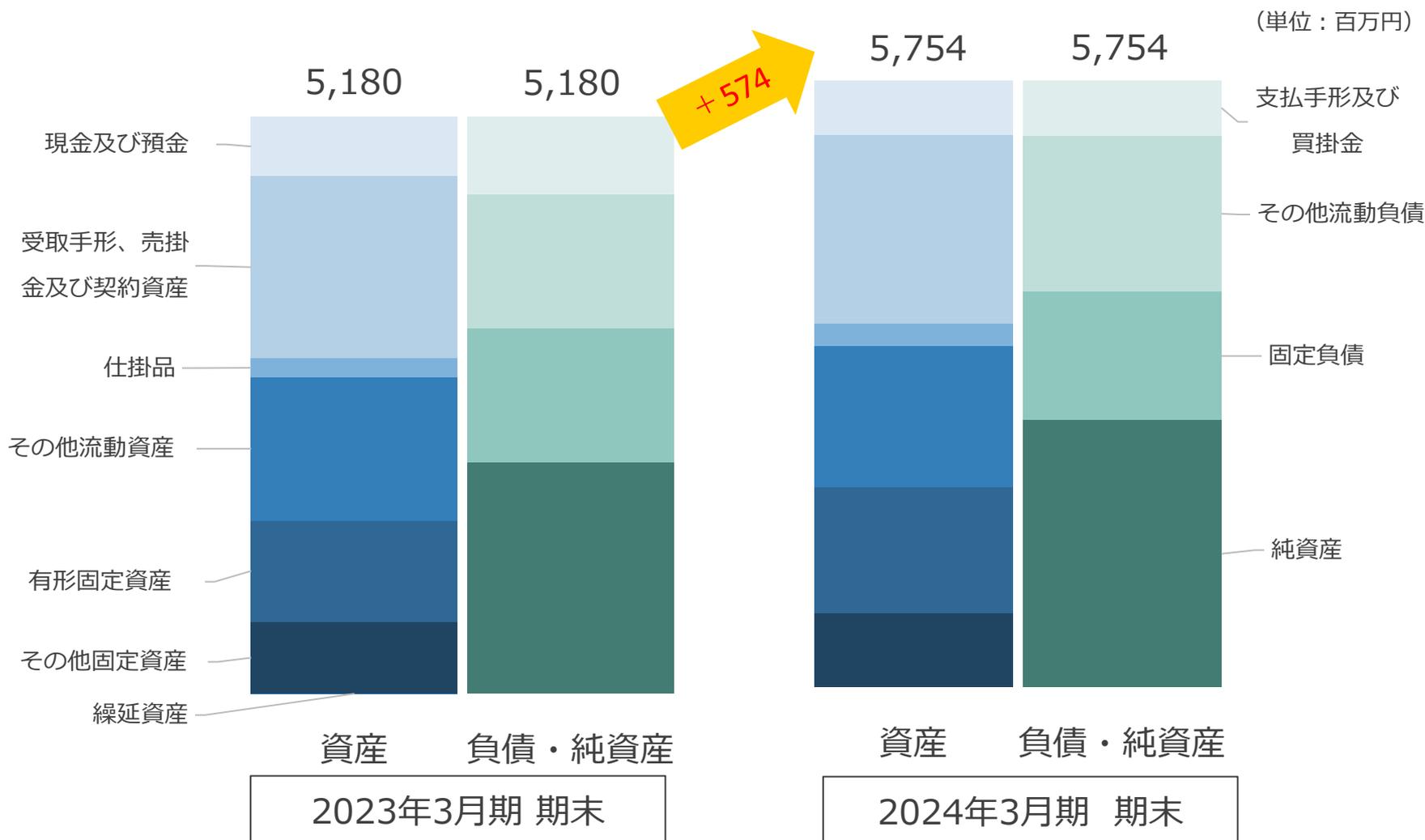
減益要因

単位：百万円

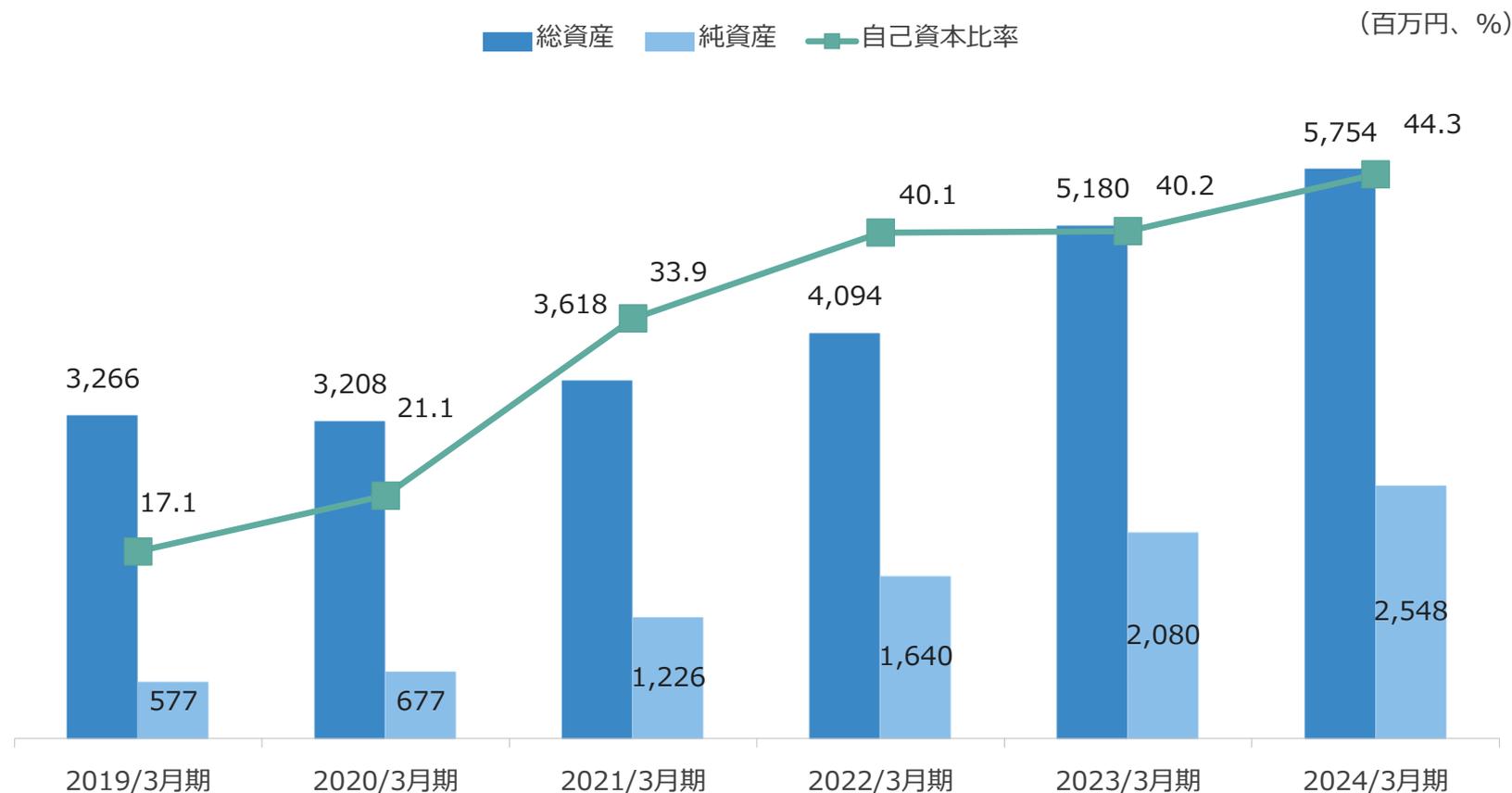


貸借対照表

【固定資産】 第二工場稼働、事業譲渡等により有形固定資産275百万円増加。
 【負債】 負債合計106百万円増加。（流動負債+99・固定負債+7）
 【純資産】 利益計上で純資産467百万円増加。自己資本比率44.3% 前期比+4.1ポイント。

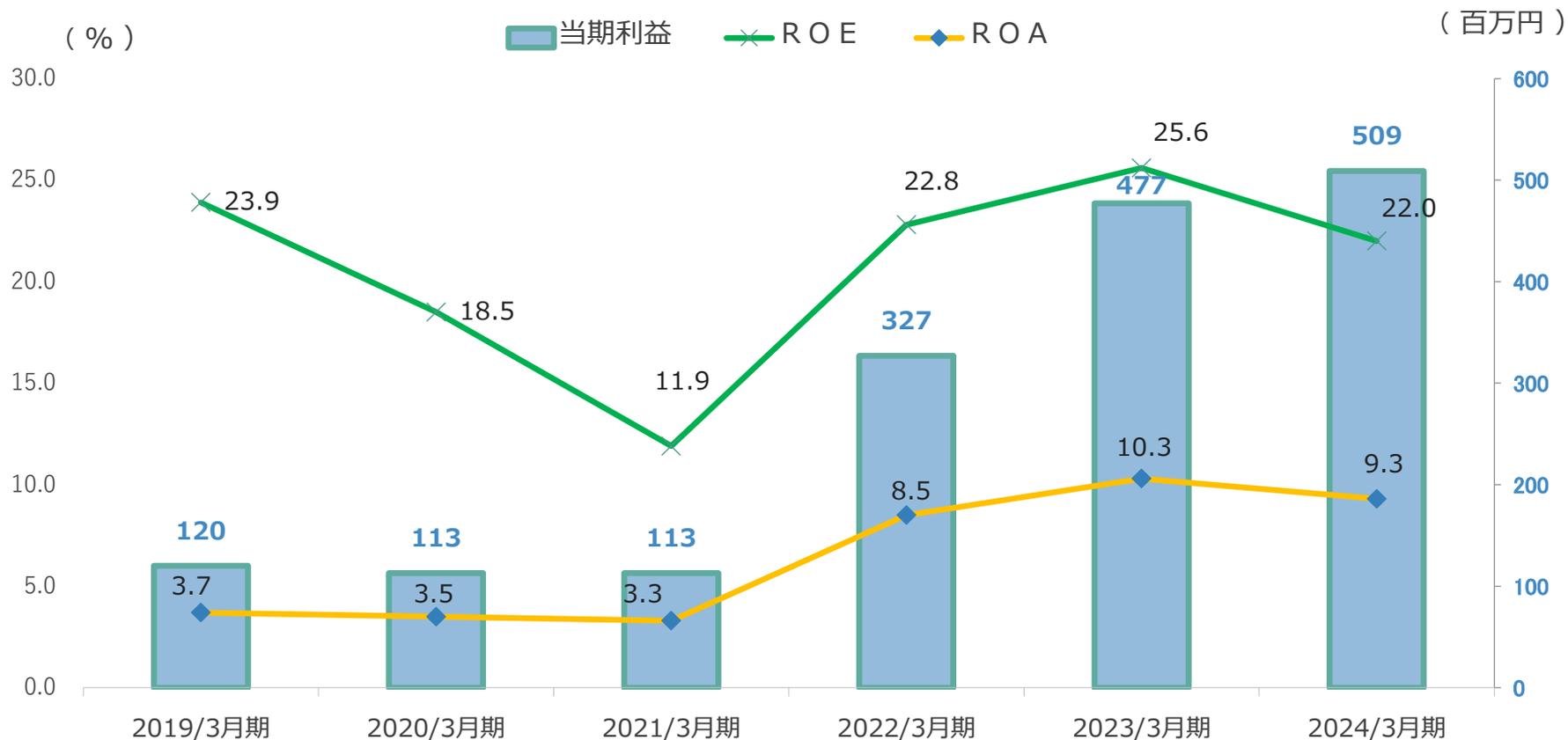


2024/3期まで自己資本比率は上昇基調、2024/3期は、着実な利益計上で純資産増加。
自己資本比率は過去最高の44.3%。（前年比では+4.1ポイント）



2024年3月期は当期利益の伸び率の鈍化によりROE、ROAともに前年比で低下するもROEは22.0%、ROAは9.3%と堅調な水準を維持。

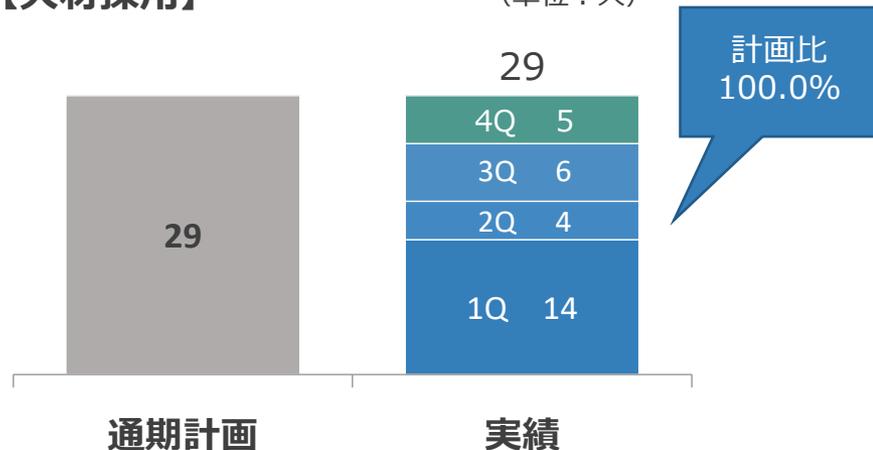
当社が認識している資本コストを上回っており、今後も積極的な研究開発投資を行い、資本コストを超えるリターンの実現に向け取り組んでまいります。



人材採用はキャリア採用の人材争奪戦の激化継続も計画通り達成。
 当初計画外ではあるが、24年1月事業譲渡によりパート含め101名の従業員受け入れ。
 研究開発は重要テーマに絞った見直し・支払時期変更を含めた日程計画見直しにより計画未達。

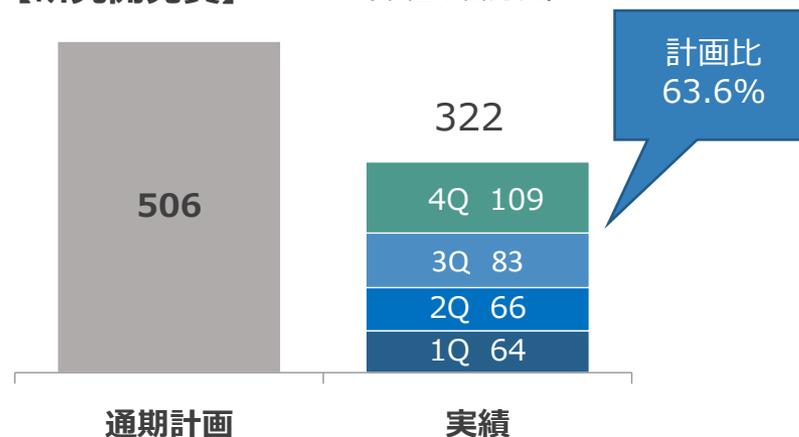
【人材採用】

(単位：人)



【研究開発費】

(単位：百万円)



主要開発テーマ

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
- ・次世代nessum(IoT-PLC)通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・次世代JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア
- ・通信用アナログデバイス

製品開発事業

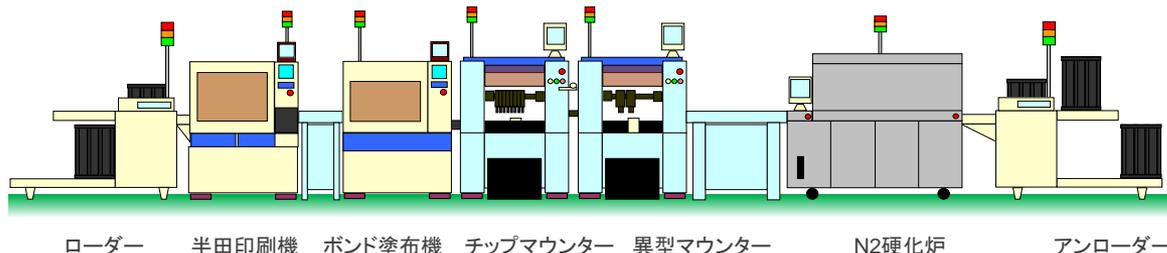
- ・介護向けシステム、センシングカメラ後継機

2023年	4月 5日 ~4月 7日	第32回 Japan IT Weekに出展	1Q
	4月 17日	130万画素MIPI出力カメラモジュール ルネサス製マイクロプロセッサ RZファミリのカメラ制御ドライバの提供開始	
	5月11日	決算発表 剰余金の配当（増配）をリリース	
	5月15日	富山県魚津市の第二工場の稼働開始	
	5月 22日	譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議	
	6月 8日	決算説明会	
	6月28日	第51期 定時株主総会	
	7月 5日	スーパーフレックスタイム制の導入	
	8月 4日	NECプラットフォームズ株式会社様より納期貢献への感謝状授与	
	8月23日	「指名・報酬委員会」設置	
8月29日	個人投資家様向け会社説明会		
9月 6日	「第二工場」ISO認証取得		
2023年	11月 14日	横浜デザインセンター開設	3Q
	12月 31日	株式会社アウトソーシングテクノロジーの一部事業譲渡成立	
2024年	1月 20日	ピンポイント着陸技術搭載した月着陸実証機「SLIM」に当社技術が寄与	4Q

2023年12月31日付 (株) アウトソーシングテクノロジー社の一部事業の譲渡成立。
概要は以下の通りです。

1. 事業所名：福島事業所 (福島製造部)
2. 所在地：福島県いわき市小名浜野田字柳町41-29
3. 業務内容：
カーオーディオチューナー製造・販売
電子部品・完成品の受託生産 (EMS)
-テレビ基板、PC光学ドライブ、無線オーディオ、カメラ、無線監査装置
4. 従業員数：101名 (パート含む)
5. 敷地面積：12,295㎡ (3,726坪)
6. 延床面積：4,487㎡ (1,360坪)
7. 保有認証：ISO9001(IATF16949) ISO14001 UL製品/工場認証
8. 沿革
1972年 7月 三進電機株式会社設立
1975年 11月 福島県いわき市小名浜にいわき工場新設 (現福島事業所)
1990年 8月 サンシン電機株式会社に社名変更
2013年 10月 株式会社アウトソーシングの連結対象子会社に
2024年 1月 電子システム事業本部福島製造部として稼働開始

■ SMTマシン 2系列 CM402 Mサイズ



■ 基板設計/装置設計

- ・高周波アナログ回路技術を元に、ワイヤレス製品の設計が得意
- ・ワイヤレス・オーディオの測定設備が多く実績も多い
- ・生産設備を自ら構築可能

■ 量産製造

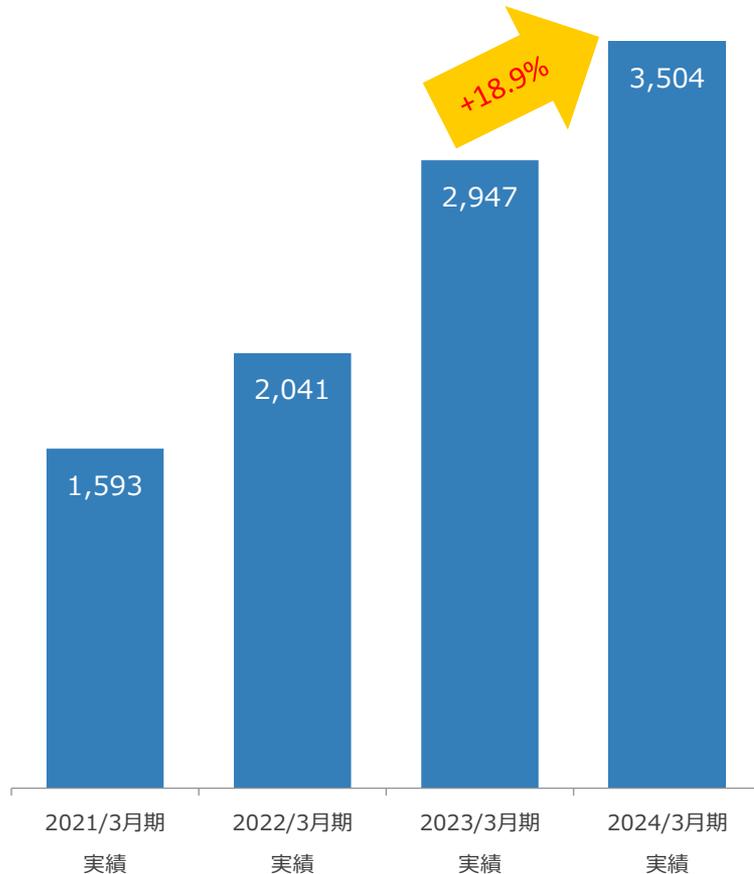
- ・大量生産を行うための仕組みになっており、リピート生産が得意
- ・SMT2系列 (生産台数：平均40万台/月)、Dip～電気検査までの生産工程が多い
- ・ハード、ソフト、基板、筐体の設計～実装まで1STOP対応可能
- ・完成品までの行程立上げも行っており、生産ライン設計・立上げ、検査治具の作成までを内製化
- ・国内でライン構築・試作、量産は海外協力工場 (マレーシア) という実績もあり



車載半導体向け中心のバーンインボードは上期好調も下期以降に市場在庫増で顧客設備投資が急減。
 パワー半導体・センサー向けのカスタムバーンイン装置は品種展開、用途展開で受注増。
 車載用専用計測機器は顧客の海外拠点展開向けもあり受注台数が4Qに増加し前期比同等まで回復。

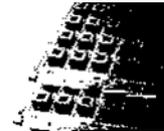
【売上高】

(単位：百万円)



2023年度トピックス

➤ 半導体装置検査装置の受注がけん引



バーンインボード
 前年比：83%



半導体検査装置販売・リース
 前年比：217%

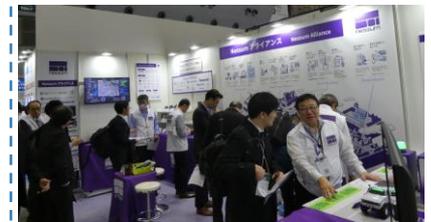


車載製品用専用計測機器関連
 前年比：99%

福島事業所開所
 福島製造部稼働開始



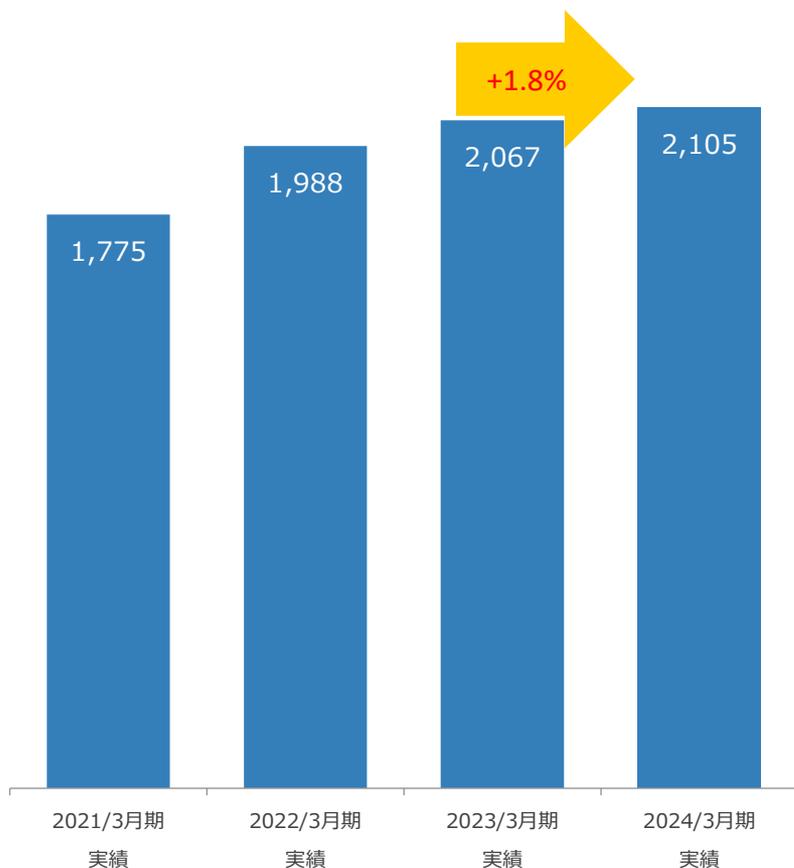
第15回 国際スマートグリッド展
 nessum (IoT-PLC) を展示



アナログは自動車向けパワー半導体設計が順調、センサー用半導体の設計はスマホ向けが堅調。
デジタルはDSC画像処理関連の設計が減少、自動車向け設計受託へのシフトは順調に推移。

【売上高】

(単位：百万円)



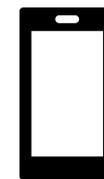
2023年度トピックス

➤ アナログ半導体設計受託

自動車向け等パワー半導体
前年比：127%



センサー用半導体
前年比：92%



➤ デジタル半導体設計受託

DSC等画像処理関連
前年比：68%



自動車関連デジタル設計
前年比：210%



セルフレジ、国内ATM、医療検体装置、カードゲームなどのカメラ搭載機器は堅調に増加するも、マイナンバーカードの医療分野以外の導入遅れにより販売計画未達。

【売上高】

(単位：百万円)



23年度 トピックス

次期新商品 試作完了

介護見守りシステム (商品名:C-エイド)

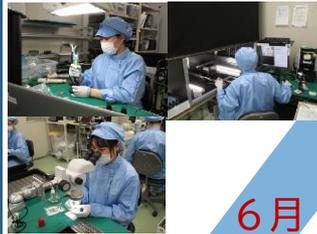


C-エイド

センサー+カメラ 一体型 見守りシステム
 商品名：C-エイド
 特長：離床、心拍、呼吸、睡眠+カメラ撮像を1台で実現
 発売予定時期：2024年秋

国際画像機器展 出展
 EdgeTech+ 2023 出展

魚津工場
 クリーンルーム拡張



7月 NECプラットフォームズ(株)様より
 納期貢献での感謝状を授与

6月 富山県ヘルスケア産業育成創出事業採択
 介護見守りシステムでの非接触離床検出精度・
 性能向上に関する研究

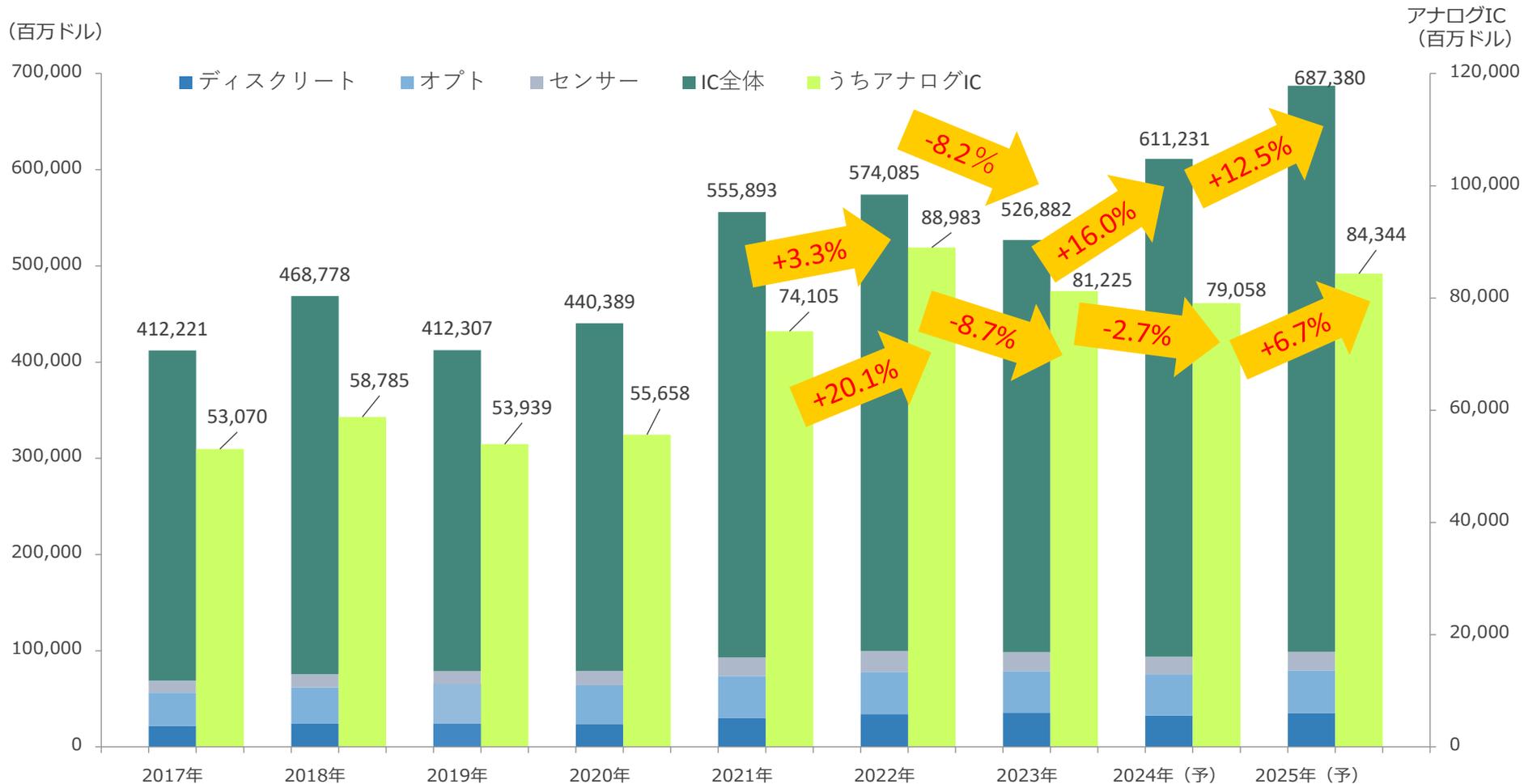
4月 Japan IT Week
 IoT・エッジコンピューティング EXPO出展

ルネサス AI Tech Day 出展、カメラ技術講演

1. 事業概要・特長
2. 2024年3月期決算の概要
3. 2025年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

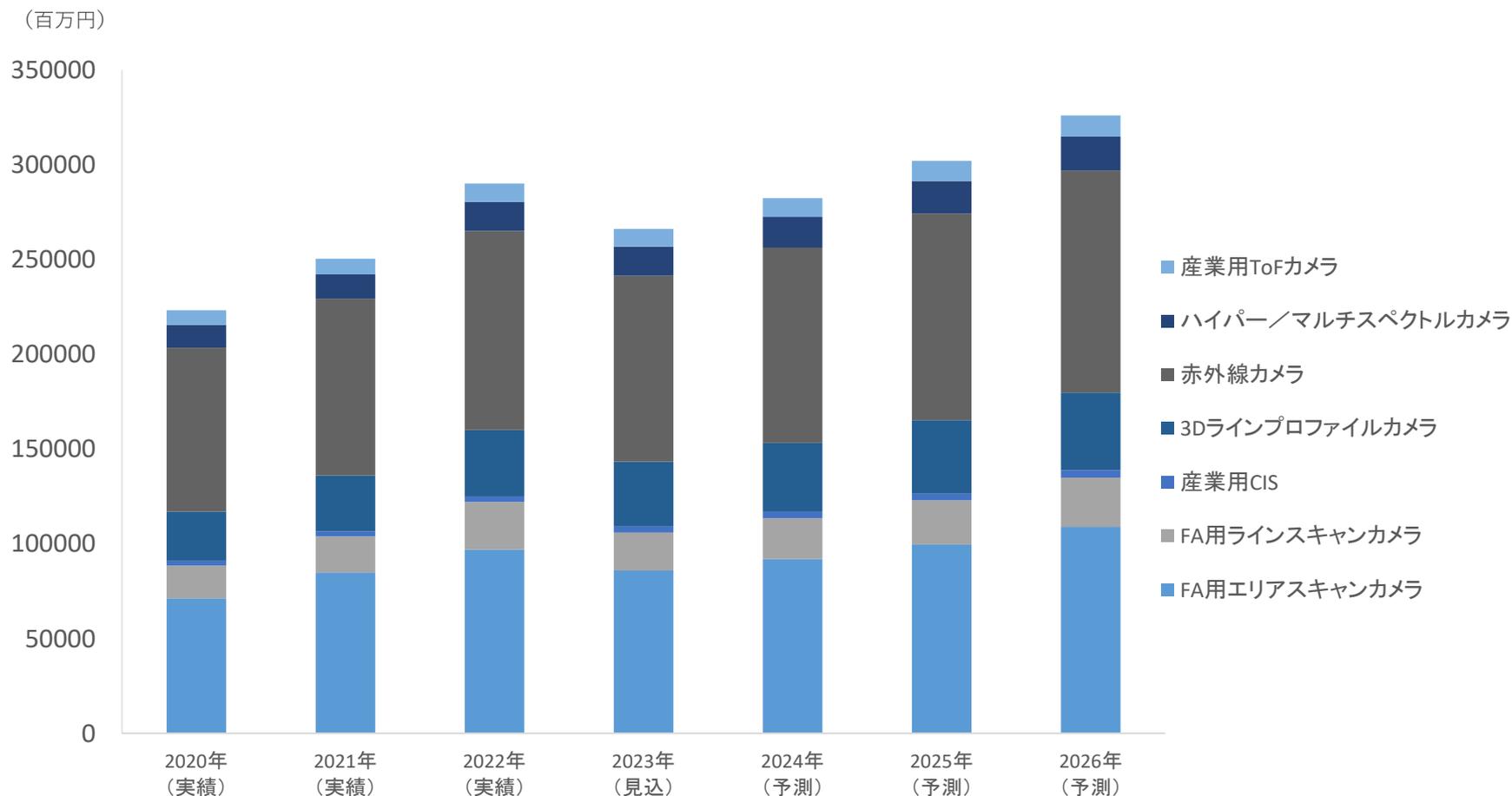
半導体市場の動向

世界半導体市場はデジタル集積回路（ロジックとメモリ）がけん引し2024-25年と2桁成長
 2024年はデジタル集積回路以外の分野（ディスクリート、アナログ等）はすべてマイナス成長
 ながら2025年はすべての分野で前年比増で全体で前年比12.5%を予想



カメラ市場の動向 (W/W)

2023 年は設備投資減少、在庫過多により全体市場は1割弱の縮小。
半導体不足の解消が進むであろう2024 年以降市場拡大が予測され、2026年度まで
毎年+6~8%の成長が見込まれている。



出所：株式会社富士経済「2024画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

●半導体関連

'23年度の市場は減少も'24年度'25年度は大幅に回復で両年とも前年比2桁増 (WSTS'24/6)
'24年度 +16.0%の市場増、'25年度 12.5%の市場増

●日本政府補助金拠出による半導体製造工場6社で'24年度2Qより順次操業開始。(Jetro '24/5)

●車載向け半導体はADAS進化により車1台当たりの搭載半導体は増え続け'28年度まで2桁成長。
(Yole Interigence '23/10)

●カメラ搭載機器は'23年度落ち込むも、V字回復し'24年度106%成長。(富士経済 '23/12)

電子システム事業

- 車載半導体は生産調整局面で当社顧客においてBIボード需要は踊り場
- デバイス(パワーデバイス等)の微細化高電力化が進み適応した装置の要望増
- EV、安全、自動運転の進化による車載ECU増加に伴う生産ライン用計測器需要が増加

マイクロエレクトロニクス事業

- イメージセンサー市場は、スマホから車載へと裾野が広がり、センサー関連半導体設計需要は堅調
- 車載向け半導体は、EV市場に一服感はあるものの、SDV化に向け車載向け半導体設計需要も堅調
- 半導体設計人材の争奪戦は継続

製品開発事業

- センサとしてのカメラ用途が認識/認証・自動化用途に拡大
- 高画素、遠隔、動画に適したIFを搭載した組込みカメラの需要増
- 中国向けFA機器需要の停滞継続

●24年度注力製品

カスタム半導体検査装置
産業用専用計測器
Nessum機器

車載関連半導体設計
センサー・パワー関連半導体設計
画像関連IP

産業機器カメラ
ATM/セルフレジ向けカメラ
見守りソリューション製品

2024年度（2025年3月期）は増収減益（戦略的な成長投資による）

- 将来の成長分野への事業化も並行して進め、生産性のより一層の向上と機動力を発揮して取り組む。
- 将来の大きな飛躍を見据え、新技術の開発に積極的に先行投資（前期比+102百万円）の継続、福島事業所の再構築、労務費のベースアップ、基幹システムの償却負担、デジタル化推進などで経常利益は▲40.5%の減益計画。

全社

(単位：百万円)

	2024/3月期 通期実績	2025/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	7,091	7,475	384	5.4%
営業利益	604	385	△219	△36.3%
経常利益	639	380	△259	△40.5%
当期純利益	509	270	△239	△47.0%
研究開発費	322	424	102	31.7%

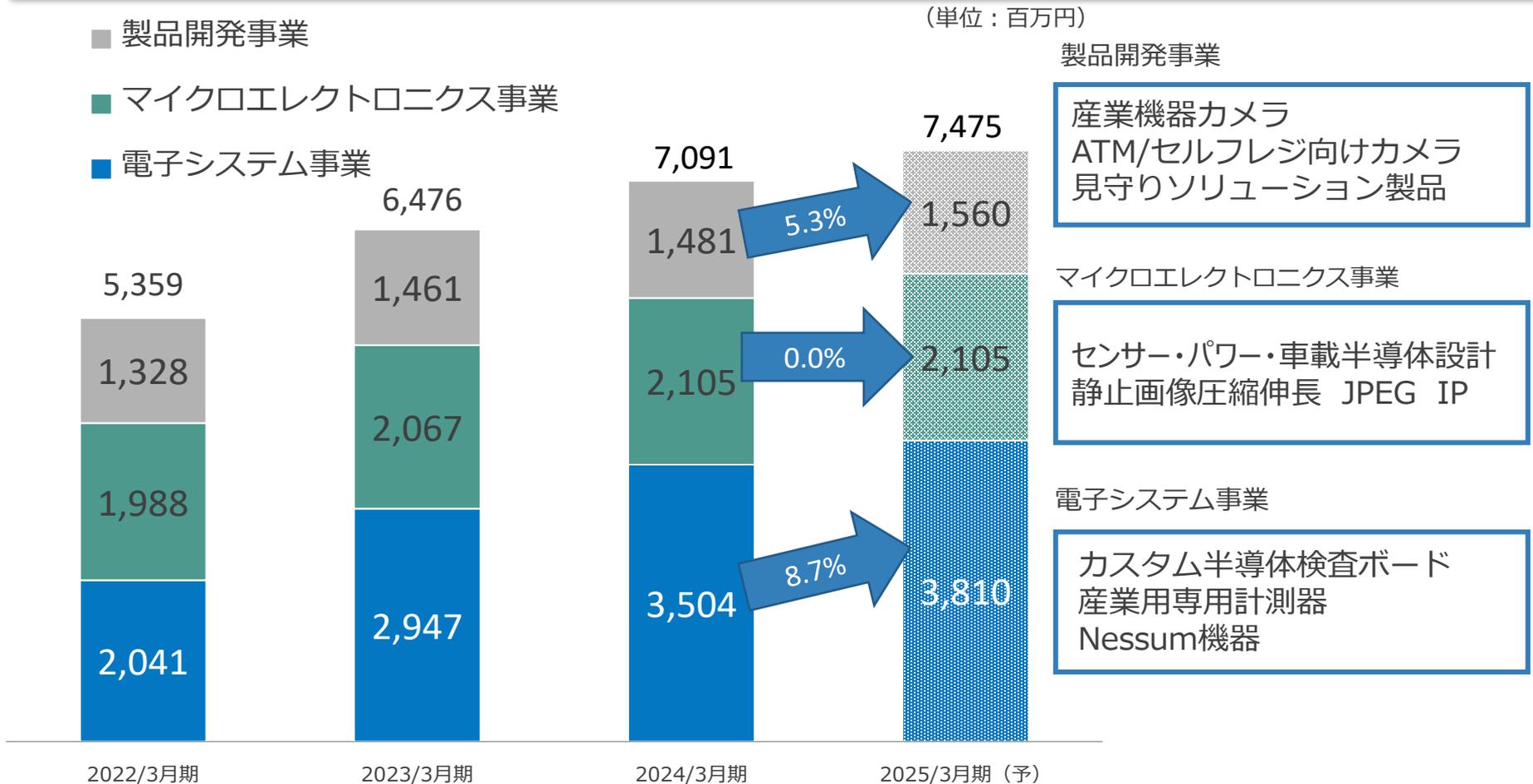
セグメント別

(単位：百万円)

	2024/3月期 通期実績	2025/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	7,091	7,475	384	5.4%
電子システム事業	3,504	3,810	306	8.7%
マイクロエレクトロニクス事業	2,105	2,105	0	0.0%
製品開発事業	1,481	1,560	79	5.3%

全事業セグメント増収

電子システム事業では福島事業所M&Aによる生産能力増強と産業用専用機器需要が増加
 マイクロエレクトロニクス事業では主要顧客維持と変動リスク緩和する顧客獲得で売上確保
 製品開発事業では製品ラインナップ増強と高付加価値商品開発で前年比+5.3%増加を見込む



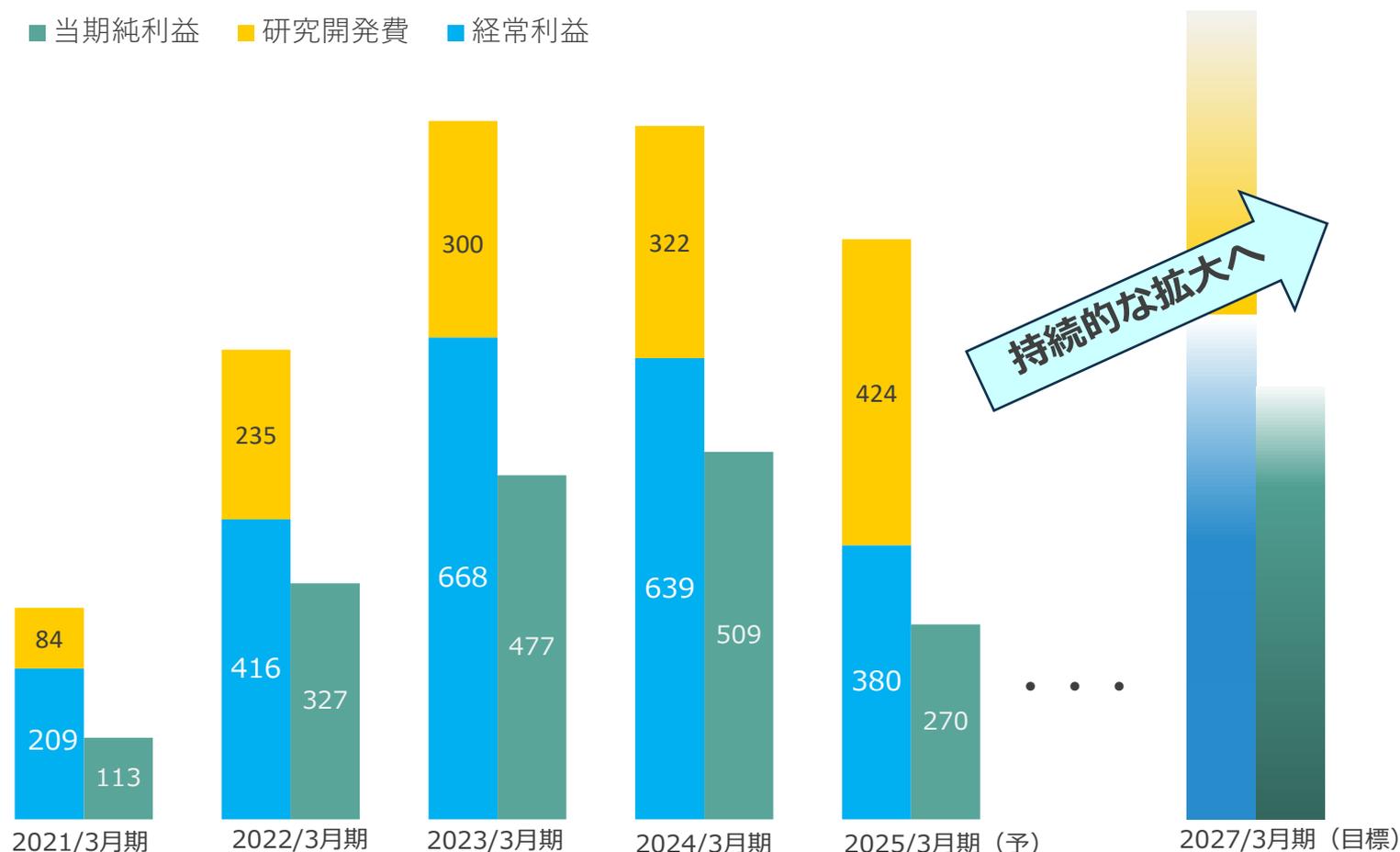
経常利益・当期純利益の推移

2024/3期は上期の活発な受注による増収増益の影響が大きく、通年でも増収となり、
経常利益ベースでは若干の減益も純利益ベースでは増益。

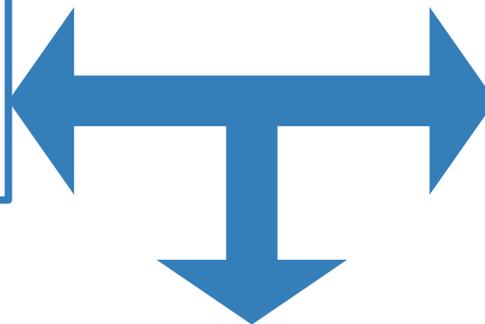
2025/3期は、成長戦略投資（開発、システム、福島事業再構築など）で増収も減益計画。

【経常利益・当期純利益】（単位：百万円、%）

■ 当期純利益 ■ 研究開発費 ■ 経常利益



将来の事業展開のための投資、
財務体質強化のための
内部留保確保



安定配当の継続実施

株主への利益還元も重視したバランス経営を推進

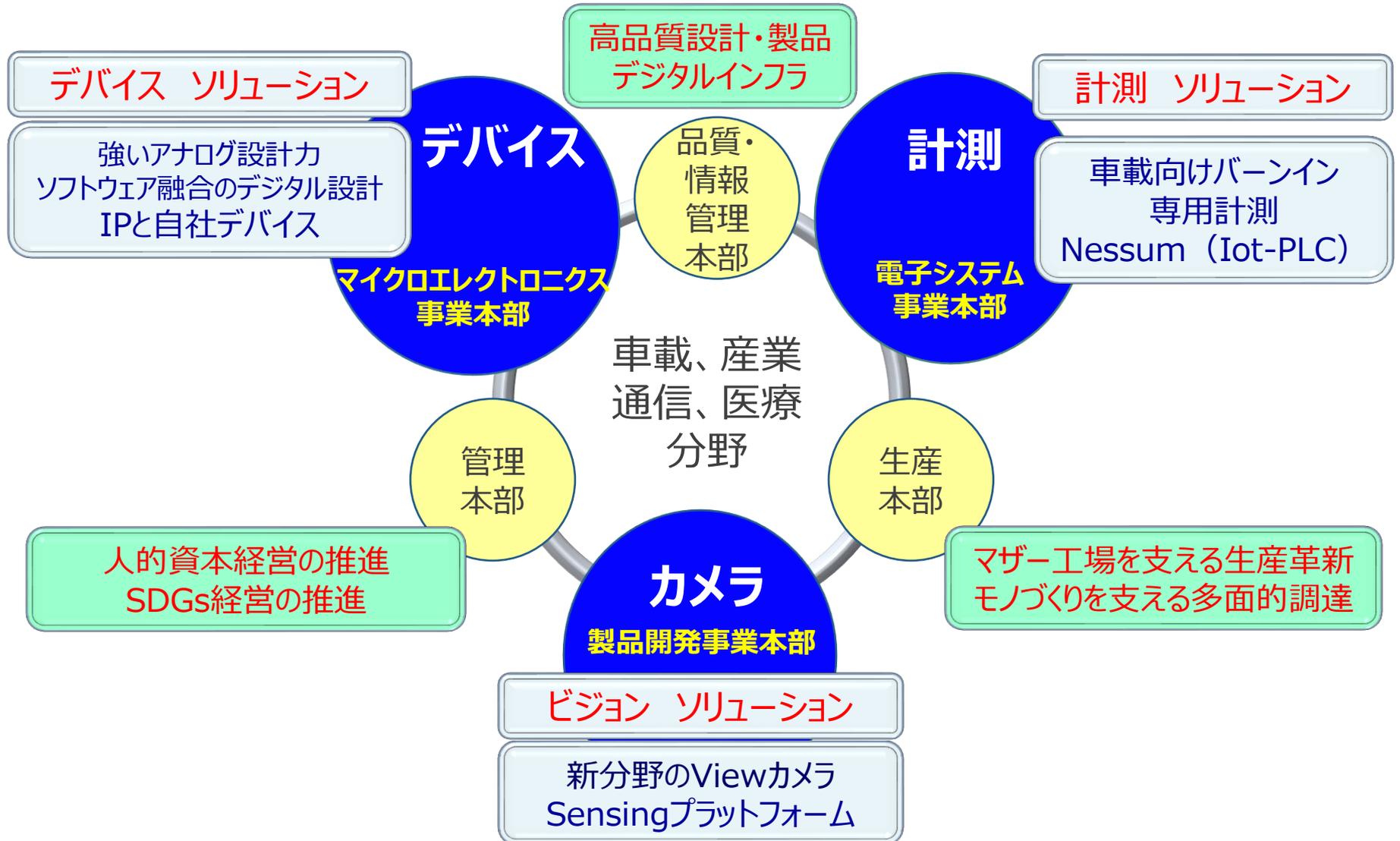
(単位：円)

	1株当たり当期純利益および配当金	
	2024/3月期 実績	2025/3月期 予想
1株当たり当期純利益	115.23	61.00
中間配当金	0	0
期末配当金	15	15
年間配当金	15	15

※2024年5月14日現在において、配当予想額は、1株当たり = 15円を予定しております。

1. 事業概要・特長
2. 2023年3月期決算の概要
3. 2024年3月期業績予想の概要
4. 成長に向けた取り組み

社会が求めるソリューションを「計測」x「デバイス」x「カメラ」で提案・実現



各事業で『コア事業の集中・安定化』と『新規成長事業』へ取り組み、継続的成長を実現

①中核事業の競争力強化

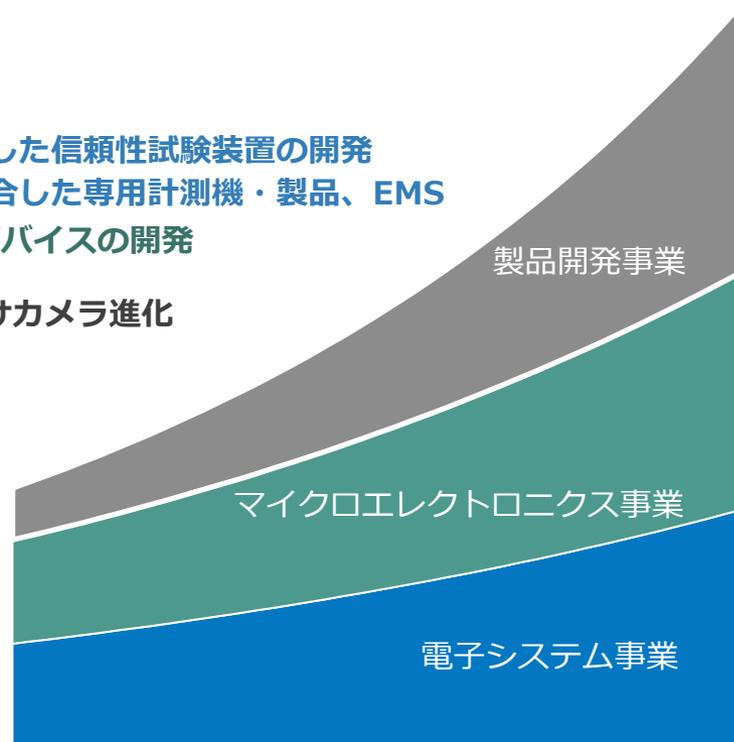
- 電子システム事業 検査機器の単品販売からソリューションへ展開
(検査機器周辺への拡張/カスタマイズ、保守メンテ、受託試験、レンタル)
- マイクロエレクトロニクス事業 . . . アナログを強化し新分野への展開、デジタルをソフトウェアで強化
- 製品開発事業 医療関連機器・産業機器への事業領域拡大による販売拡大

②新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- 電子システム事業 新機能・新デバイスに適応・進化した信頼性試験装置の開発
福島製造部技術・モノづくりと融合した専用計測機・製品、EMS
- マイクロエレクトロニクス事業 . . . JPEGやISPのIP機能進化と自社デバイスの開発
- 製品開発事業 3D・AI技術導入しセンシング向けカメラ進化

③新市場、グローバル戦略の拡大

- 電子システム事業 OSATを足掛かりにした海外展開
Iot-PLC市場参入
- マイクロエレクトロニクス事業 . . . IP販売のグローバル展開
- 製品開発事業 画像応用製品での事業化推進
グローバル展開



売上高	: 74.7億円	(対前年	5.4%)
経常利益	: 3.8億円	(対前年	▲40.5%)
当期純利益	: 2.7億円	(対前年	▲47.0%)

経営方針

成長へ向けた事業・ビジネス基盤確立の着実な推進

- 製品・技術の先鋭化とグローバルビジネスの加速 -

- ✓ **成長ターゲット新分野・新製品での着実な売上貢献**
- ✓ **基盤事業の商品・技術の先鋭化、グローバル販売の実現**
- ✓ **中期を見据えた生産効率化の徹底推進・収益性改善**
- ✓ **新基幹システム、業務インフラデジタル化の完遂**

- 温度制御技術の強みを活かしBI事業のソリューション展開で拡大
- 重点顧客専用計測機の高シェアを維持し、IoT-PLCで新たな売りを作る

中核事業の競争力強化

- ◆ BI事業モデルをソリューションに拡張、お客様の多様な要望に応える
- ◆ 重点顧客向け車載機器専用検査装置のバリエーションを拡大

新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ 車のCASE進展に伴うBI装置の技術進化

新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ 新領域・グローバルでのビジネスにチャレンジ

昨年度の進捗

- 第二工場本格稼働開始、信頼性装置製造・受託試験のキャパシティ拡大
- IoT-PLCカスタム製品の量産品の納入を開始

本年度重点事項

- 産業機器事業の拡大に向け福島事業所を再構築
- 台湾OSAT向けBI装置の立ち上げを通じてグローバルビジネスを加速

- アナログ設計強化とデジタル設計+ソフト技術融合でエンジニアリング事業基盤を強化する
- IP商品の展開と自社ASICで新たな事業を作る

中核事業の競争力強化

- ◆ 顧客の水平展開・技術領域拡張しエンジニアリング事業を強化

新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ IPの機能進化と自社デバイスの開発

新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ IPのグローバル販売を強化

昨年度の進捗

- エンジニアリング新横浜拠点の開設、車載分野へのリソースシフト
- 自社アナログデバイス探索開発完了し半導体Fabへ試作投入。

本年度重点事項

- JPEG-XL規格IP商品化、自社デバイス商品化開発への移行
- 自社及び協業パートナー連携で『アナログIP』ビジネス立上げ

- ビューカメラはインフラ・産業で顧客拡大、センシングカメラは性能強化で用途拡大
- 画像応用製品（ビジョンソリューション）で医療・AI応用に参入し新規事業を作る

中核事業の競争力強化

- ◆ インフラ機器のDX化を視野にセンシング向け商品ラインナップを強化

新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ AI画像処理に適した新製品開発を加速

新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ 画像処理技術を活かした新領域でのビジネスにチャレンジ

昨年度の進捗

- 見守り製品の試作品開発と富山県内施設評価を完了し量産開発へ移行
- 本社工場リニューアルしカメラ組み立てクリーンルームを拡大

本年度重点事項

- 協業パートナー連携も含め製品ラインナップを拡充
- 欧州市場をターゲットとしたグローバル拡販の開始
- 見守り製品の市場投入、初年度は富山県内施設から開始

- 「人」が主役の経営、人的資本経営の本格化
- システム導入による効率化推進

人的資本投資

- ◆ 新教育・研修制度充実 ◆ 人事・評価制度の見直し ◆ 従業員満足度向上

デジタル化の推進

- ◆ 新基幹システム、業務インフラのデジタル化の完遂

SDGs に向けた取り組み

- ◆ 働き方改革による働き甲斐アップ、環境改善への投資、社会貢献など

昨年度の進捗

- カーボンニュートラルへの第1弾（第二工場の全電力を再エネ電力に）
- 新教育制度運用開始（eラーニングなど）、人事評価制度の一部見直し

本年度重点事項

- 新基幹システムの本格稼働
- カーボンニュートラルへの第2弾（太陽光発電由来の電力導入契約）
- 教育・研修制度の本格化（選抜教育、節目教育）、人事評価制度

APPENDIX

バーンイン (ボード)	バーンインは、半導体の初期不良を除去する選別方法の1種。バーンインボードは、通常の使用環境であれば2～3年以内で故障するおそれのある半導体を取り除くテスト工程（パッケージバーンインテスト）で用いられる基板。半導体製品の動作を検証、初期不良品を選別。
LSI	大規模集積回路。ICのうち、素子の集積度が1,000個～10万個程度のものを「MSI」（Medium Scale Integration）、1万ゲート位までのものを「LSI」と呼ぶ。これ以上はVLSI（Very Large Scale Integrated Circuit）と呼ばれている
IC	半導体集積回路。トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの素子を集めて基板の上に装着し、各種の機能を持たせた電子回路。（Integrated Circuit）
I/F回路 (アイエフ回路)	受信機・通信機において周波数変換された信号を処理する電子回路。
FPGA	プログラムすることができる論理LSI。マイクロプロセッサやASIC（特定用途のために設計されたIC）の設計図を送り込んでシミュレーションすることが可能。（Field Programmable Gate Array）
ASIC	特定の用途のために設計されたIC。フルカスタムICは注文に応じてゼロから設計、セミカスタムICはあらかじめ特定の機能を持った回路ブロックを組み合わせた「半完成品」をもとに、配線を変えることで要求に合わせたもの。（Application Specific Integrated Circuit）
JPEG	静止画像データの圧縮方式の一つ。圧縮の際に若干の画像劣化を許容する（劣化許容レベルの指定が可能）方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことが可能、現在のデジタルカメラのほとんどは、記録画像のファイル形式にJPEGを使用。（Joint Photographic Experts Group）
IP	再利用可能な設計資産（知的財産）。ICの設計と製造の分業化により、IPが独自の市場を形成。（Intellectual Property）
MIPI	企業団体MIPI Alliance(本部米国：ノキア、テキサス・インスツルメンツ等により設立)が策定する、モバイル機器のカメラやディスプレイとのインターフェイス規格。（Mobile Industry Processor Interface）
CMOS	半導体の一方式であるMOS（半導体の中で動いている自由電子が、自由電子が飛び出した後の正孔のいずれかによって電荷が運搬されるトランジスタ）を改良したもので、電荷の運搬に自由電子と正孔の両方を用いるため、MOSに比べて動作速度が高い特徴があります。（Complementary Metal Oxide Semiconductor）

ご清聴ありがとうございました

本資料および決算説明会で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

【お問い合わせ先】

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>